

经过改善的PTH和PIMD性能

优点

- 使用 DK3.5 改进 PIMD
- 改进的 PTH 质量
- 在高频下稳定
- 在高温下稳定
- 较低的水分吸收率
- 绝佳的剥离强度
- 极高的性价比

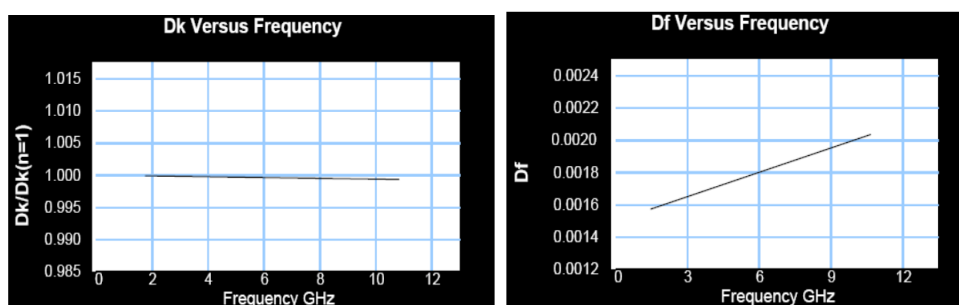
产品应用

- 尺寸有效的天线
- 功率放大器
- LNA, 中继器 PA
- 无源组件
- 滤波器/耦合器

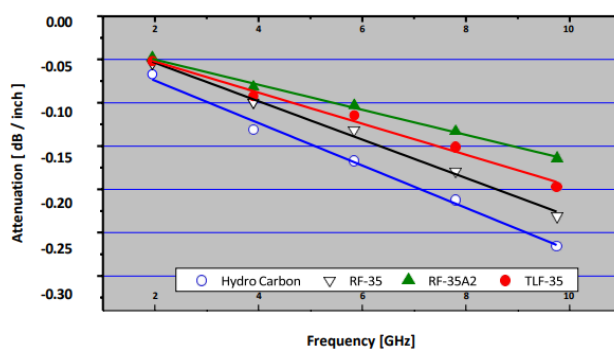


TLF-35A 是 AGC 产品系列中的有机陶瓷层压板。TLF-35A 高级版是低成本，大容量商用微波和射频应用的最佳选择。TLF-35A 高级版对 1/2 盎司和 1 盎司铜具有绝佳的剥离强度，旨在提供优异的高频性能。高级 TLF-35A 层压板显示出与 TLF-35A 相似的电气性能，但具有更紧密的 DK 公差。

TLF-35A 高级版旨在针对天线应用在尺寸有效的板上获得增强的 PIMD 性能。大多数敏感的 PIMD 所需基材的介电常数约为 3.0，而 TLF-35A 高级层压板的介电常数为 3.5，具有相似的 PIMD 水平。



总衰减(微带谐振器)



用微带环形谐振器来测量总衰减。

受试材料为 20 mil 介电厚度和 1 盎司铜

属性	条件	典型值	单位	试验方法
电气性能				
介电常数	@ 10 GHz	3.50 ± 0.05		IPC-TM 650 2.5.5.5.1 Mod
损耗因数	@ 10 GHz	0.0026		IPC-TM 650 2.5.5.5.1 Mod
表面电阻率		3.0 × 10 ⁹	Mohms	IPC-TM 650 2.5.17.1
体积电阻率		2.0 × 10 ⁸	Mohms/cm	IPC-TM 650 2.5.17.1
热性能				
导热系数		0.37	W/m/K	IPC-TM-650 2.4.50
CTE (50°C ~ 150 °C)	X	9	ppm/°C	IPC-650 2.4.41
	Y	12		
	Z	80		
机械性能				
剥离强度	1 oz. copper	1.8 (10)	N/mm (Lbs./linear in)	IPC-TM 650 2.4.8
抗弯强度	Lengthwise	90 (13,000)	N/mm ² (psi)	IPC-TM 650 2.4.4
	Crosswise	90 (13,000)	N/mm ² (psi)	
物理/化学性能				
易燃性			V-0	UL-94
吸水率		0.03	%	IPC-TM 650 2.6.2.1

典型厚度	
Inches	mm
0.030	0.76
0.060	1.52

可用的板材尺寸			
Inches	mm	Inches	mm
12 x 18	305 x 457	18 x 24	457 x 610
16 x 18	406 x 457	36 x 48	914 x 1,220

可用铜覆层						
规范	重量	铜厚	Rms 处理面		说明	
CVH (CH)	½ oz./sq. ft.	~ .0007"	~ 18µm	19µin	0.48µm	极低轮廓 / 电沉积
CV1 (C1)	1 oz./sq. ft.	~ .0014"	~ 35µm	25µin	0.64µm	极低轮廓 / 电沉积
CLH	½ oz./sq. ft.	~ .0007"	~ 18µm	18µin	0.46µm	反向处理 / 电沉积
CL1	1 oz./sq. ft.	~ .0014"	~ 35µm	16µin	0.41µm	反向处理 / 电沉积
C2	2 oz./sq. ft.	~ .0028"	~ 70µm	27µin	0.69µm	电沉积
CVH (CH)	½ oz./sq. ft.	~ .0007"	~ 18µm	19µin	0.48µm	极低轮廓 / 电沉积
CV1 (C1)	1 oz./sq. ft.	~ .0014"	~ 35µm	25µin	0.64µm	极低轮廓 / 电沉积

- * 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。
- * TLF-35A可按 0.030 英寸(0.76 毫米)的增量制造。
- * 标准面板尺寸为 18 英寸 x 24 英寸(457 毫米 x 610 毫米)。
- * 有关其他厚度，其他尺寸和任何其他类型的覆层的可用性，请联系 AGC。

